

令和2年8月17日

FIoT コンソーシアム

ハイブリッドMEMS デバイス分科会

会長 小林 健

主査 山下 崇博

令和2年度 第1回ハイブリッドMEMS デバイス分科会開催のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当コンソーシアムの分科会活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。今回はMEMS デバイスと印刷技術の融合によるハイブリッドMEMS デバイスの開発を進めている産業技術総合研究所センシングシステム研究センターハイブリッドセンシングデバイス研究チームによる最新技術の紹介、海外の研究動向に関する講演、関連施設の見学をいたしたく、下記要領にて第1回分科会を開催いたします。ご出席のほど、よろしくお願いいたします。

敬具

記

日時：2020年9月4日(金) 13:30~16:15 (13:00 受付開始)

会場：産業技術総合研究所 つくば東事業所 本館1階第2会議室

予定議題：

13:30~13:35 開会挨拶

ハイブリッドMEMS デバイス分科会 会長 小林 健

13:35~14:00 講演「ハイブリッドMEMSの基礎」

産業技術総合研究所センシングシステム研究センター

ハイブリッドセンシングデバイス研究チーム 研究チーム長 小林 健

14:00~14:30 講演「中国におけるMEMS研究開発」

産業技術総合研究所 名誉リサーチャー 前田 龍太郎

14:30~14:45 講演・デモンストレーション「ハイブリッドMEMSスピーカー」

産業技術総合研究所センシングシステム研究センター

ハイブリッドセンシングデバイス研究チーム 主任研究員 山下 崇博

15:00~16:00 ハイブリッド MEMS 関連施設見学

16:10~16:15 閉会挨拶・事務連絡等

ハイブリッド MEMS デバイス分科会 主査 山下 崇博

※今回は会場の受け入れ可能人数の関係上、誠に恐縮ながら、募集人数を【20名まで】とさせていただきます。(原則1社1名様、申込順。)

※ご来訪の際のお願い

- ご自宅で体温測定をしていただき、発熱や体調不良(軽い風邪の症状)のある場合は、当分科会へのご参加を控えてください。また、海外渡航から帰国後2週間以内の方は来訪不可となります。
- 当分科会開催会場へのご来場時に、当分科会スタッフが非接触型の体温計を使用して検温させていただきます。検温結果によっては、当日の分科会参加をご遠慮いただく場合がございます。
- 当分科会会場ご滞在中は、必ずマスク着用をお願いいたします。また、マスクを外している状態での会話はお控えください。
- 当分科会開催会場へのご来場時に、アルコールによる手指消毒にご協力ください。また、当分科会スタッフによる分科会開催会場の除菌清掃の徹底を行います。

事務局：

国立研究開発法人産業技術総合研究所センシングシステム研究センター内

FIoT コンソーシアム ハイブリッド MEMS デバイス分科会担当

E-mail：M-ssrc-fiot-hymems-ml@aist.go.jp

電話：029-862-6063(山下)

アクセス：

産業技術総合研究所 つくば東事業所

〒305-8564 茨城県つくば市並木 1-2-1

https://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/east/tsukuba_map_e.html